

泰凌微电子（上海）股份有限公司

投资者关系活动记录表

证券简称：泰凌微

证券代码：688591

编号：2024-009

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	通过上证路演中心网络互动参与公司2024年半年度业绩说明会的投资者
时间	2024年9月13日 11:00-12:00
地点	上海证券交易所上证路演中心 (网址： https://roadshow.sseinfo.com/)
上市公司接待人员姓名	董事、总经理：盛文军 副总经理、董事会秘书：李鹏 财务总监：边丽娜 独立董事：刘宁
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、互动交流问答主要内容如下（已合并相似问题）</p> <p>Q1：中央汇金公司今年历史性首次建仓科创板，买了大量的科创板相关的ETF并且还在不断买入科创板相关ETF，而ETF作为耐心资本，会长期配置指数成分股，入选指数成分股的上市公司会获得更多的发展资源和进入更大的发展平台，为了泰凌微的长远发展，泰凌微作为芯片行业相关细分市场的龙头企业，有没有考虑将“大力推动泰凌微入选科创50指数成分股或其他宽基指数成分股”作为公司的重要经营与管理目标？</p> <p>A1：一方面，公司过往的经营与管理目标的确主要集中在业务发展、产品技术创新、经营管理效率等维度；另一方面，去年以来整个二级市场的表现出现了一些大的波动与变化，诸多企业都受到了一定影响，科创50指数或一系列宽基指数会有各自对应的入选规则。公司接下来会详细研究各类指数的评选规则，结合公司的实际情况，将合理且有利于公司持续健康发展的目标与经营发展规划进行有机结合，以期能对泰凌微后续的发展起到更好的指引作用。</p> <p>Q2：公司如何做好下半年的毛利率管理？</p> <p>A2：这两年随着市场的环境改善，公司海外更高毛利的销售收入占比上升，同时，公司在物联网中高端市场的销售</p>

占比上升，供应链采购成本开始下调，使得公司毛利率在持续回升。下半年公司将持续保持销售和供应链优势，2024年全年来看，毛利率有望进一步改善和提升。

Q3: 请问贵公司的产品优势具体是如何体现的？

A3: 公司各类产品竞争优势显著，目前公司产品进入多个有较高技术门槛的细分市场，被大量国内外一线品牌所采用。公司的蓝牙低功耗 SoC 芯片长期位于市场的首要位置，成为全球第一梯队的代表之一。在 Zigbee 领域，公司是出货量最大的本土 Zigbee 芯片供应商，并稳居全球前列，在本地和国际市场上有强劲竞争实力。此外，公司的 Thread 和 Matter SoC 芯片紧跟最新的协议标准，在国际头部芯片供应商中占据重要地位。公司还在 2.4G 私有协议 SoC 领域取得领先地位，特别是在键鼠和电子价签为代表的主要应用市场。在无线音频 SoC 方面，公司支持多种无线音频技术，包括最新的蓝牙低功耗音频技术，其芯片已成功进入国际头部品牌的产品线，这些产品竞争力也在公司的盈利能力、客户矩阵上得以体现。

Q4: 请问公司现金流情况如何，何时转负为正？

A4: 公司现金流情况良好。其中，2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为正，金额为 1,939.19 万元，经营活动可为公司持续提供现金流入；投资活动产生的现金流量净额主要变化系公司利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买三个月及以上定期存款所致；筹资活动产生的现金流量净额变化主要系本报告期进行股份回购所致。

Q5: 请问公司目前在手合同情况如何？

A5: 公司的产品被大量国内外一线品牌所采用，包括谷歌、亚马逊、小米等物联网生态系统；罗技、联想等一线计算机外设品牌；创维、长虹、海尔等一线电视品牌；JBL、Sony 等音频产品品牌；欧瑞博、绿米等智能家居品牌。

2024年上半年，公司在各个物联网细分市场持续取得进展，在智能家居、商用智能照明市场都获得了可喜进展。公司进一步加强了和谷歌、亚马逊等大型互联网生态企业的合作，公司芯片被其生态链重要合作伙伴所采用，实现了大批量的出货。公司的音频芯片出货取得了明显的增长，公司音频芯片被包括 JBL、Sony、小米等一线厂商所采用，由于这些厂商新项目开始出货和已有项目订货量的增加，公司音频芯片出货量获得了显著增长。

总体看，公司产品销售情况良好，具备持续性。

	<p>Q6: 请问公司后续将采取什么措施进一步稳定股价? A6: 去年以来, 整个二级市场的表现出现了一些大的波动与变化, 诸多企业都受到了一定影响, 公司也密切关注自身股价的二级市场表现, 前期也积极通过回购、分红等方式开展股价维护以及提升投资者回报。 公司后续会持续做好经营发展工作, 提升自身基本面表现, 同时也会密切关注资本市场动向, 积极学习相关案例经验, 通过多种举措争取给投资者带来更优秀的中长期的投资回报, 切实履行上市公司的责任和义务。</p> <p>Q7: 公司实际经营过程中对半导体行业回暖的感受如何? A7: 2024年上半年, 公司的存货周转效率同比有较大提升, 加之本公司加强存货管控, 并优化成本, 2024年上半年毛利率为46.18%, 较上年同期提高2.99个百分点, 产品的盈利能力还在提高。收入方面, 上半年公司实现营业收入36,557.70万元, 较上年同期同比增长14.67%, 去年以来公司保持了稳健的收入表现。</p> <p>Q8: 公司上半年在产品技术方面有何建树? A8: 上半年, 公司通过积极的研发投入和产品开发, 进一步巩固和增强了现有多项核心技术, 不断增加和拓宽核心技术覆盖领域, 并由此研发出相关产品。在此期间, 公司完成了 Zigbee R23 协议栈的认证, Matter 协议 1.3 版本的认证。公司采用先进工艺以及高性能电路设计相结合的方式, 发布了新一代系统级低功耗蓝牙芯片, 在国内同类型芯片中首次达到低于 2mA 量级的峰值单芯片射频接收电流水平, 推出的超低功耗多协议物联网无线 SoC 芯片是国内首颗实现工作电流低至 1mA 量级的多协议物联网无线 SoC (实测结果), 在市场同类产品实现了里程碑的突破。 公司在下一代低功耗蓝牙标准基础上, 自研的低功耗无线高精度定位芯片、算法及软件协议栈技术, 能够在较少增加硬件面积的情况下, 实现室内高精度定位, 并已在先导客户中进行导入。公司基于先进工艺平台研发的包含多个 RISC-V MCU, 高性能 DSP 等异构多核集成的单芯片, 在提升音频和复杂数字信号处理能力的同时, 提供高可靠、高效率协议栈调度等能力, 并兼顾低功耗性能, 相关产品已经在先导客户进行导入。</p>
上传日期	2024年9月13日